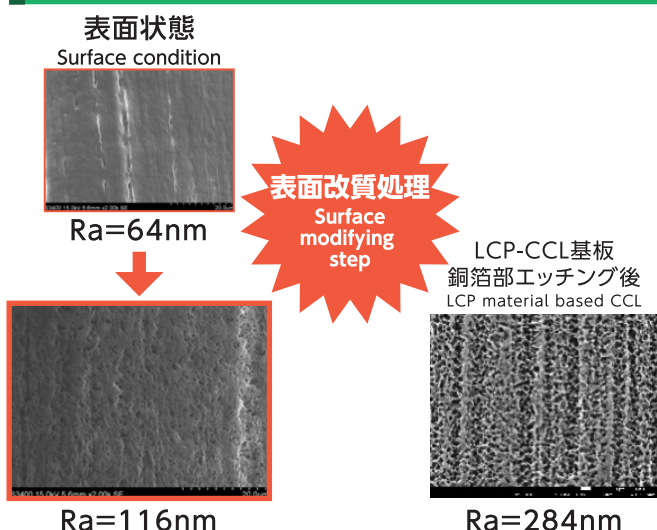


高周波対応液晶ポリマー(LCP)フィルムの無電解銅めっきプロセス Electroless copper plating process for liquid crystal polymer (LCP) films for high-frequency

トップLECSプロセス TOP LECS PROCESS

- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへのめっきプロセス
Realize plating to LCP films suitable for high-frequency, high-speed transmission
- Roll to Roll 処理に適応しためっきプロセス
Plating process for Roll-to-Roll wet process
- 表層の平滑性を維持し、かつ高い密着性が得られる
Maintain surface smoothness to realize high adhesion
- セミアディティブプロセスに対応し、ファインパターン性に優れる
Applicable for SAP and excellent in fine pattern formation

高速伝送に適した低粗化プロセス Low-roughening process suitable for high-speed transmission

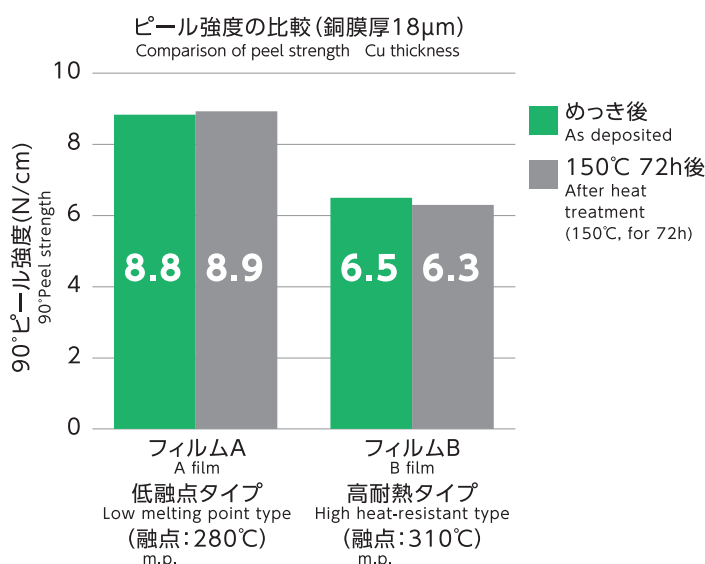


低粗度でのめっき処理が可能
Low roughness pretreatment is possible

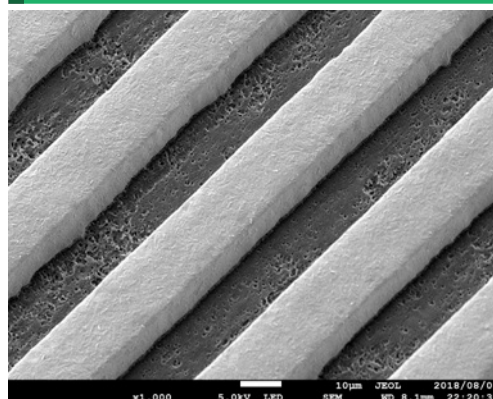
Roll to Roll による 無電解銅めっきが可能 Electroless copper plating by Roll-to-Roll machine



優れたピール強度 Excellent peel strength



ファインパターン形成が可能 Excellent in fine pattern ability



パラジウム吸着量が少なく、
パターンニング性に優れる
Reduce Pd adsorption amount,
excellent in pattern forming performance